

お客様各位

電子機器 2018 トータルソリューション展のご案内

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび弊社は初めて展示会に出展することにしました。日頃から格別のご愛顧を賜っております皆様方にぜひご高覧のうえ、率直なご意見やご感想をお聞かせいただきたく存じます。ご多用中恐縮でございますが、ぜひ来場くださいますようご案内申し上げます。

敬具

トープロテクノサービス株式会社

代表取締役 北條 武

記

会期：2018年6月6日（水）～8日（金）の3日間

会場：東京ビッグサイト 東展示棟内特設会場（予定）

出展ブース：「2018 マイクロエレクトロショー」の特別イベント「eX-tech2018（エクステック 2018）」※複数社が1連に並ぶようなイメージでの1小間に出展。

展示内容（予定）

① 自社開発している「AI設計」（開発中）について

構想2年、開発着手1年程度になります。人材確保しようともなかなか若い人が見つからない昨今。これまで培った設計技術をどうにか伝承できないか？（高品質な設計）、社内で蓄積した設計データを活かす手立てはないか？、波のある設計業務を人海戦術だけではなく効率化が図れないか？（早く・多く）、解析シミュレーションと連携したレイアウト設計にも対応した設計技術を確立できないか？、ヒトとAIの融合として部分的な自動化ができないか？、新しい人を雇用しても育成プログラムが充実できていない・・・など、思案していたところAIを思いつき協力いただける会社と出会い、共同開発を開始しました。

部品配置～配線を自動で行うAIになります。実投入までにはまだ時間を要しますが、今回の展示会で色々なニーズをお聞きし、さらに学習内容を追加していきたく考えております。

② 電源ICまわりの設計方法について

実際に弊社で失敗したことから各種セミナーなどに参加して部品商社様と出会い、調査および勉強を開始しました。実際に、日本でのアートワーク設計（レイアウト設計）によるミスが多く問題が起きているようです。今回は約8種類の設計パターン別による実装基板を作製し、測定した結果を公開いたします。